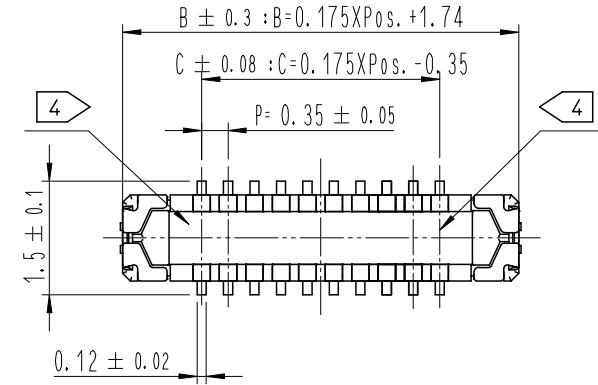
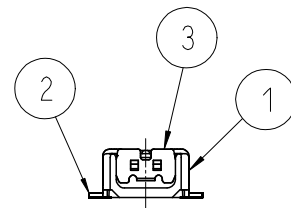
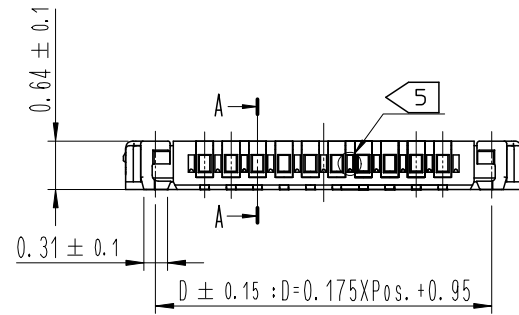


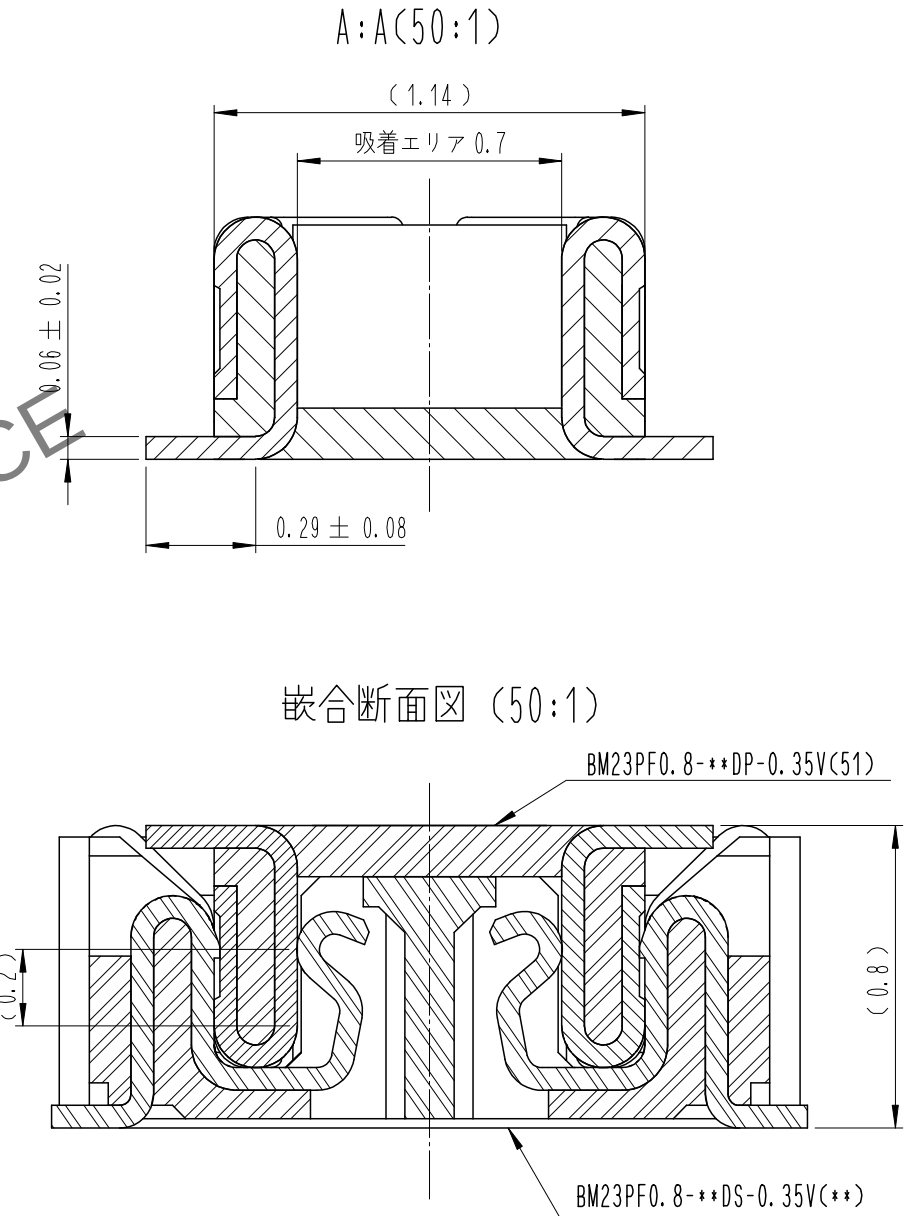
	COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	B	Y	CHKD	DATE		COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	B	Y	CHKD	DATE
△						. .	△						. .
△						. .	△						. .
△						. .	△						. .



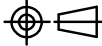
DRAWING FOR REFERENCE
This is subject to change without notice



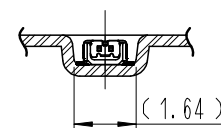
PART No.	CODE No.	POS.	B	C	D
BM23PF0.8-10DP-0.35V(51)	-	10	3.49	1.40	2.70
BM23PF0.8-14DP-0.35V(51)	-	14	4.19	2.10	3.40
BM23PF0.8-20DP-0.35V(51)	-	20	5.24	3.15	4.45
BM23PF0.8-24DP-0.35V(51)	-	24	5.94	3.85	5.15
BM23PF0.8-40DP-0.35V(51)	-	40	8.74	6.65	7.95
BM23PF0.8-42DP-0.35V(51)	-	42	9.09	7.00	8.30
BM23PF0.8-46DP-0.35V(51)	-	46	9.79	7.70	9.00
BM23PF0.8-54DP-0.35V(51)	-	54	11.19	9.10	10.40



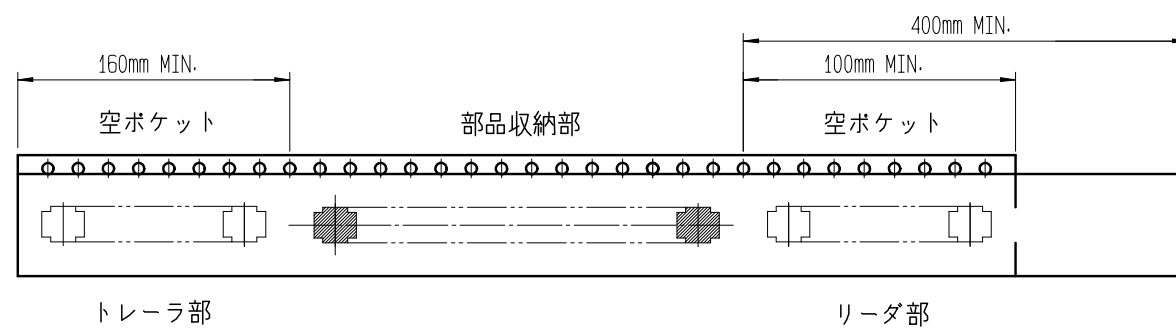
- 注 1. 平坦度は0.08mm以下となります。
2. 端子めっき仕様
接触部 : 金めっき 0.05μm MIN.
実装部 : 金めっき 0.05μm MIN.
下地 : ニッケルめっき 1μm MIN.
(表面 : 封孔処理)
3. 補強金具めっき仕様
接触部 : 金めっき 0.05μm MIN.
下地 : ニッケルめっき 1μm MIN.
(表面 : 封孔処理)
4. 図示近傍に HRSマーク または CAV No を表示します。
5. 製品側面に凹みを設ける場合があります。

4	PS	CLEAR, エンボスカバーテープ			
3	りん青銅	3	7	PS	CLEAR, 補強用カラー
2	りん青銅	2	6	PS	BLACK, プラスチックリール
1	LCP	UL94 V-0, BLACK	5	POLYESTER	CLEAR, カバーテープ
NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS
REMARKS				DRAWN S. H. MOON 17. 01. 26	DESIGNED S. H. MOON 17. 01. 26
				CHECKED H. W. JO 17. 01. 26	APPROVED T. S. KANG 17. 01. 26
				RELEASED 17. 01. 26	
CODE NO. (OLD)		DRAWING NO.	PART NO.		
	SCALE 10:1	JDC3-*****	BM23PF0.8-**DP-0.35V(51)		
	UNITS mm	 HIROSE KOREA CO., LTD.	CODE NO	CL 66***-*****-***	
					1 3

	DRAWING NO.		PART NO.	
	JDC3-*****		BM23PF0.8-**DP-0.35V(51)	
SCALE	HIROSE KOREA CO., LTD.		CODE NO	
10:1			CL 66*-*****-***	
UNITS			3	
mm				

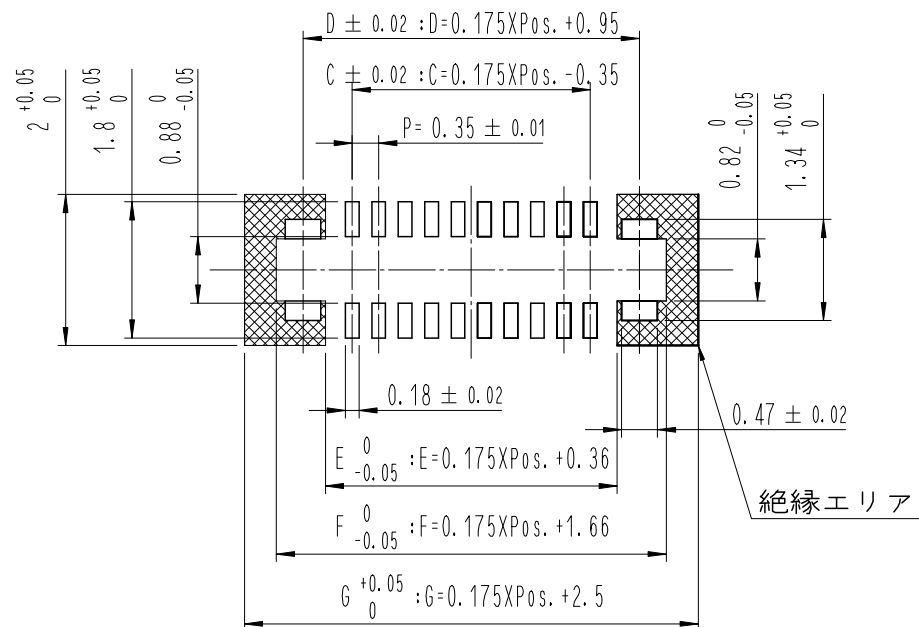


POS.	H	J	K	L	M
10	12	5.5	3.65	13.5	17.5
14	16	7.5	4.35	17.5	21.5
20	16	7.5	5.40	17.5	21.5
24	16	7.5	6.10	17.5	21.5
40	24	11.5	8.90	25.5	29.5
42	24	11.5	9.25	25.5	29.5
46	24	11.5	9.95	25.5	29.5
54	24	11.5	11.35	25.5	29.5



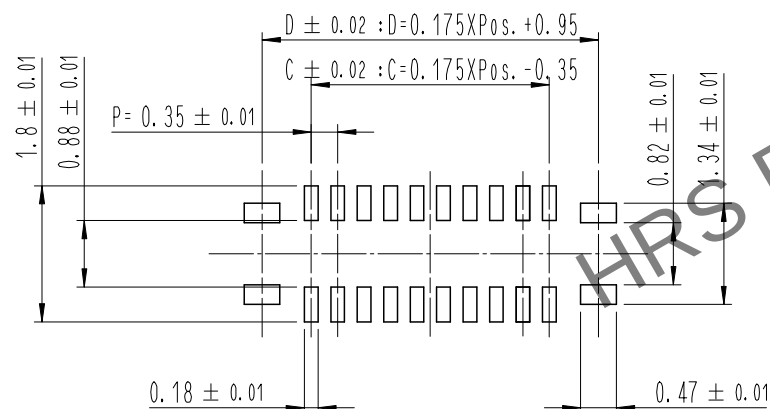
Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

7>◆推奨基板パターン図



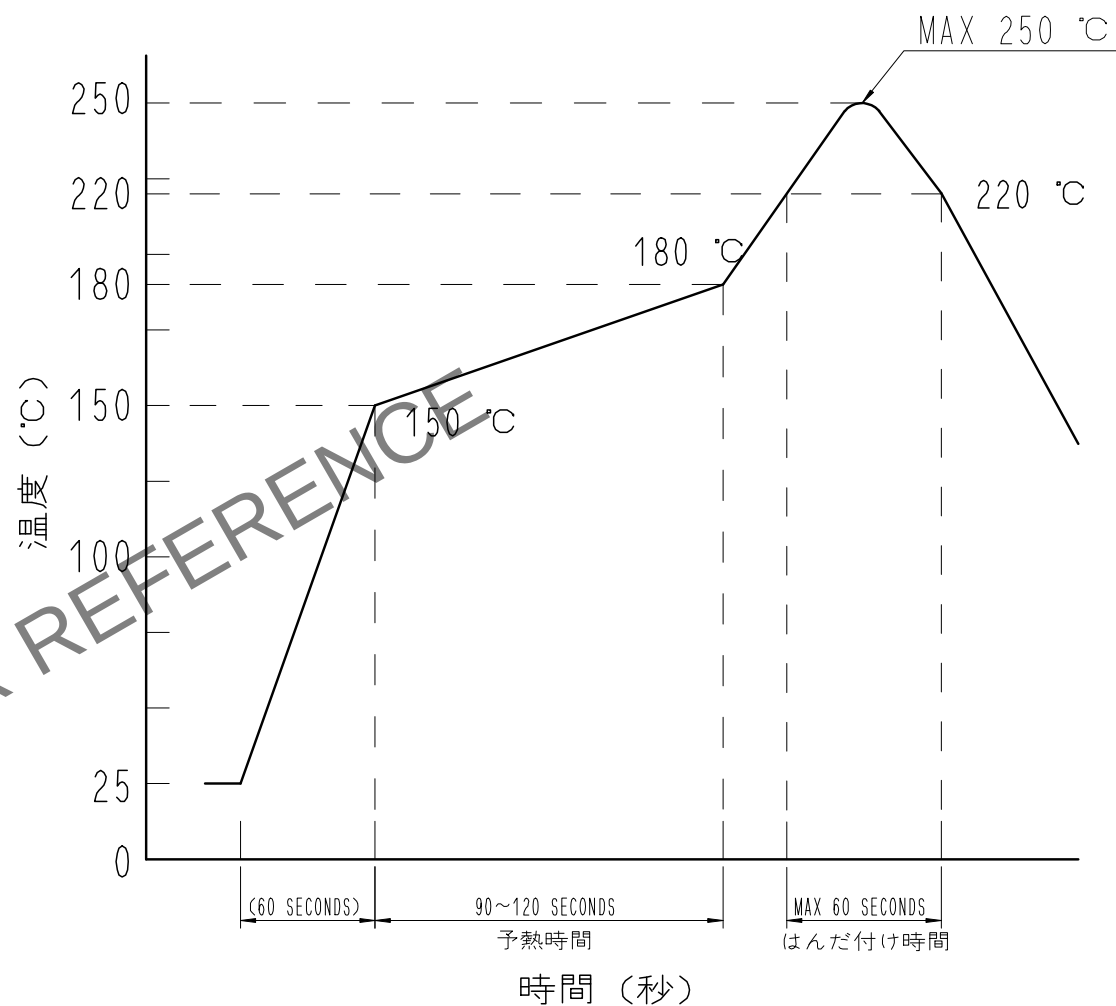
◆推奨メタルマスク開口部図

メタルマスク厚 : 100 μm



POS.	C	D	E	F	G
10	1.40	2.70	2.11	3.41	4.25
14	2.10	3.40	2.81	4.11	4.95
20	3.15	4.45	3.86	5.16	6.00
24	3.85	5.15	4.56	5.86	6.70
40	6.65	7.95	7.36	8.66	9.50
42	7.00	8.30	7.71	9.01	9.85
46	7.70	9.00	8.41	9.71	10.55
54	9.45	10.75	10.16	11.46	12.30

6>鉛フリークリームはんだの温度プロファイル（推奨）



リフロー方式：IRリフロー

リフロー回数：2回以下

1)本加熱

220°C以上 60秒以下（ピーク温度250°C）

2)予備加熱

150~180°C 90~120秒

6> 温度はコネクタリード部近辺の基板表面温度を表します。
この温度プロファイルは上記適用条件のものです。

クリームはんだの種類、メーカー、基板サイズ、その他実装
部材等の条件により異なる場合がありますので、実装状態
を十分ご確認の上ご使用願います。

7> 上記の推奨条件と、異なる設定を行なう場合は、弊社にご連絡を下さい。

	DRAWING NO.	JDC3-*****	PART NO.	BM23PF0.8-**DP-0.35V(51)	
	SCALE	10:1	CODE NO	CL 66**-*****-**-**	2/3
	UNITS	mm			